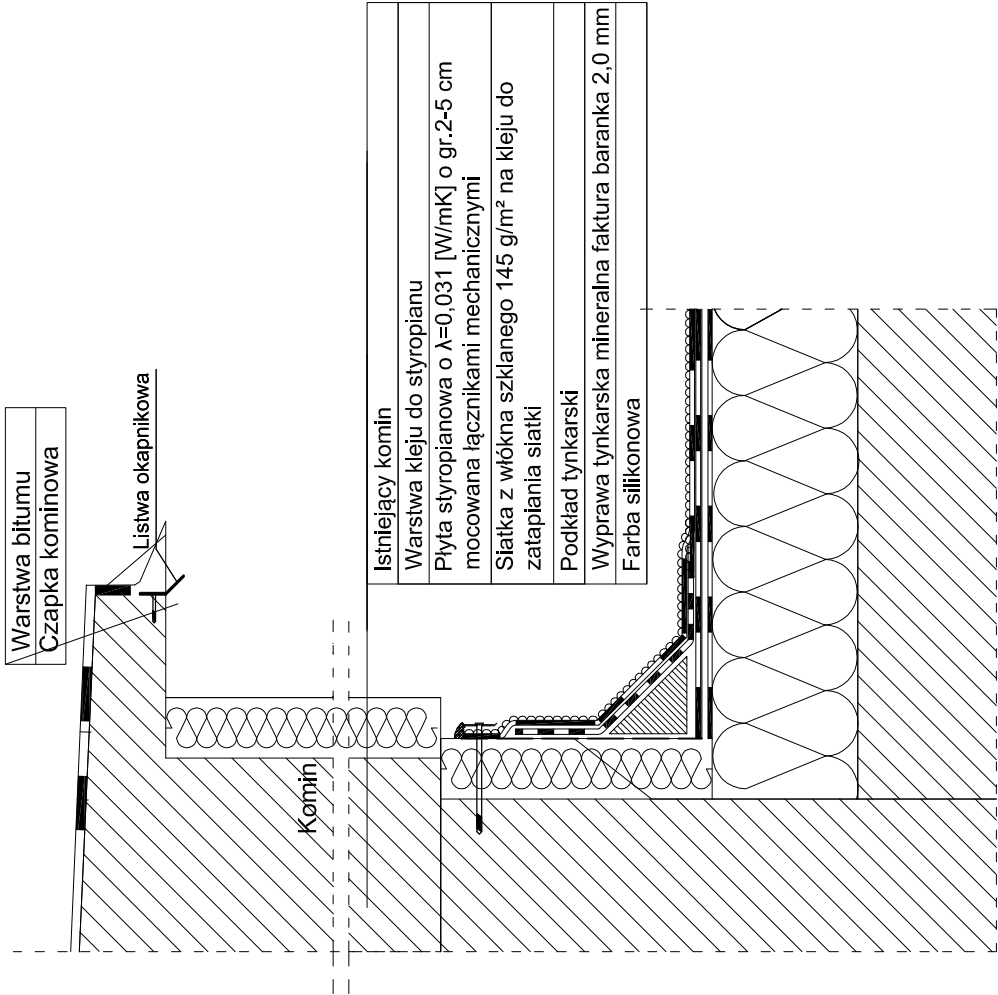


Rys. B-2 Detal obróbki komina

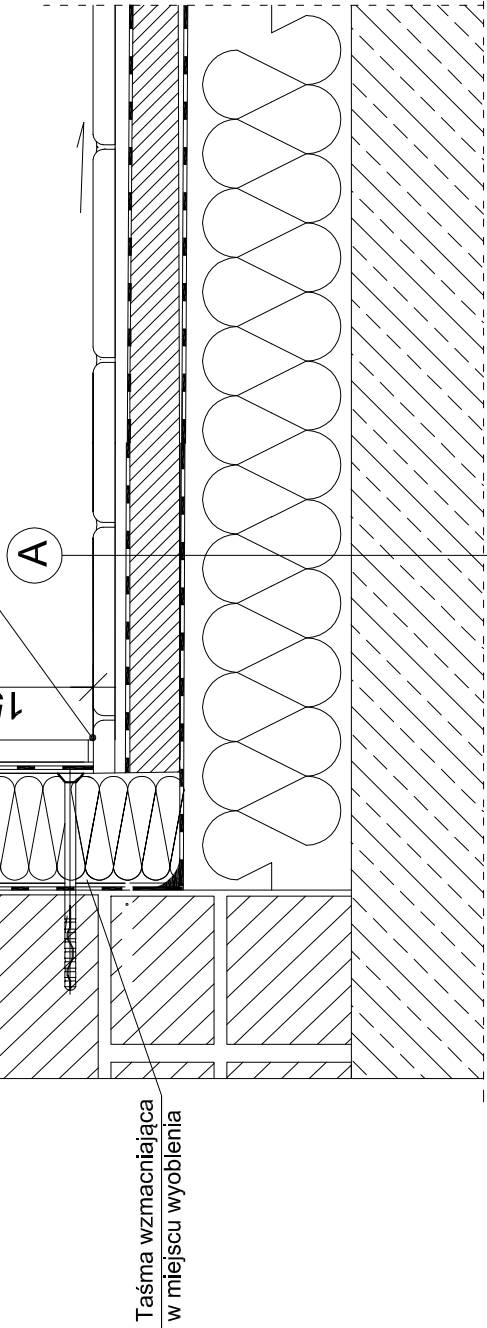


A	Płytki ceramiczne (niepalne), antypoślizgowe, mrozoodporna) przyklejone do podłoża za pomocą zaprawy klejowej
	Półpłynna elastyczna zaprawa klejowa
	Izolacja szlamowa gr. min. 3 mm
	Szlachta dociskowa gr. min. 40 mm
	Izolacja bitumiczna z papy termogrzewalnej gr. 4,5 mm
	Izolacja termiczna ze styropianu gr. 25 cm λ=0,036 W/mK
	Zaprawa naprawcza o gr. od 10-50 mm ułożona ze spadkiem 0,5-1%
	Zaprawa kontaktowa (szczerwina)
	Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia zaprawą
	Istniejąca płyta żelbetowa

Listwa startowa
Taśma rozprężna

Uwaga :
Spadek płyty balkonowej należy wyprofilować na warstwie zaprawy naprawczej.

Uszczelka akrylowa do zastosowania zewnętrznego

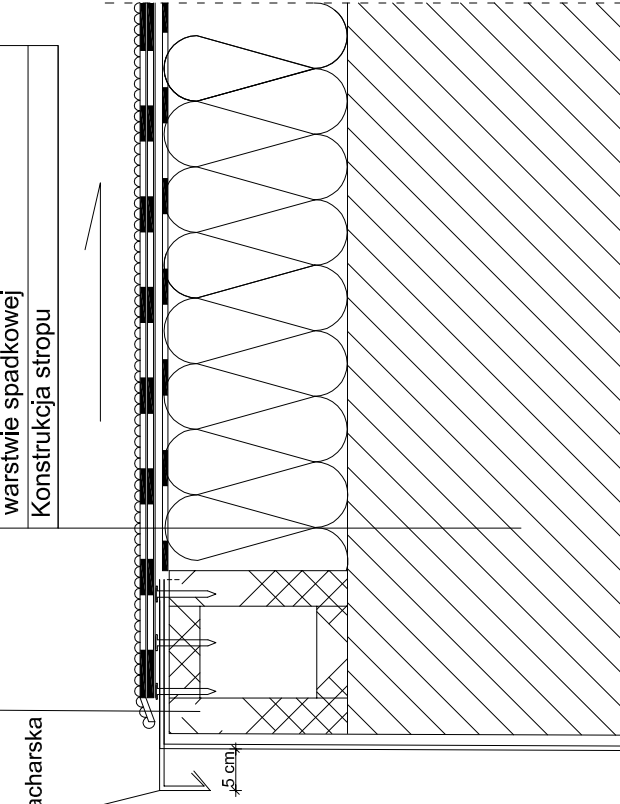


Rys. B-1 Detal remontu stropów podcienia

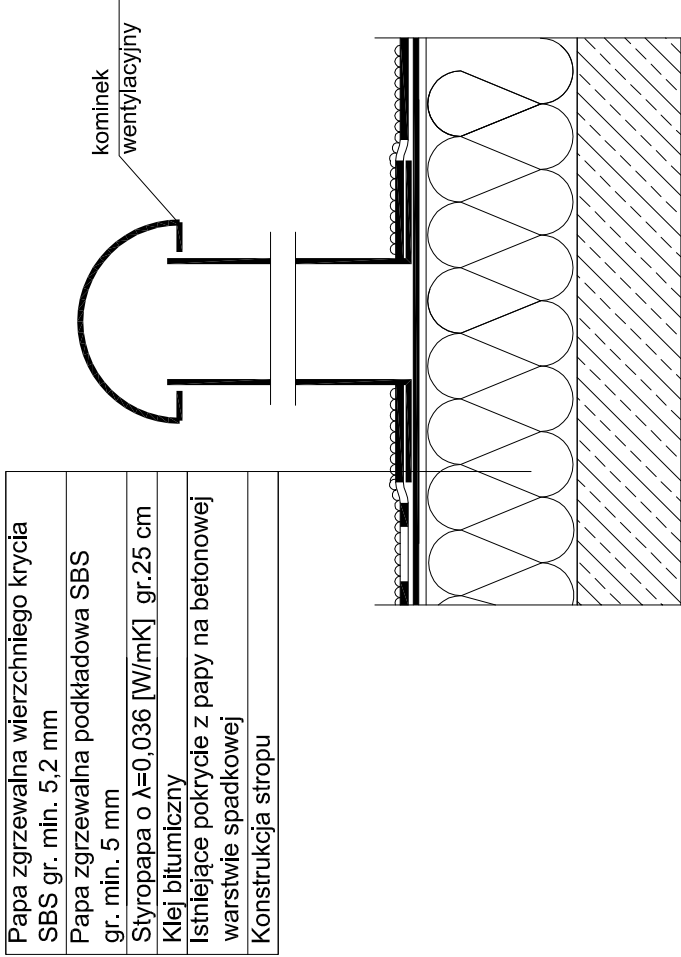
Rys. B-3 (a) Detal dachu

Bekła oporowa - przekrój skrzynkowy

Obróbka blacharska



Rys. B-3 Detal poszycia dachu z kominkiem wentylacyjnym



Nazwa Inwestycji		PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA ŚCIAN W GRUNCIE, DOCIEPLENIA STROPODACHU I WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ORAZ BUDOWY WENTYLACJI	
Inwestor		budynku biurowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce dz. nr ewid. 183/2 obręb 146401_1.0041	
Generalny Projektant		MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa	
Projektant		mgr inż. Leszek Tischner	nr ewid. 157/2002
Sprawdzający		mgr inż. Damian Cyra	MAZ/0003/POK/08
Asystent		mgr inż. Ewelna Grochowska-Kuzak	
Tytuł rysunku:			
DETALE: B-1, B-2, B-3			
Data: VII 2018 r.	skala 1:5	Rys. nr: 8	